

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

581

ML10

Erstellt:

Landwehr, Melanie

Kunde:

Datum:

17.12.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	220		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-ML-0.10mm-018+018-TG150-HF	50200646	18	L2	4
		100		
		18	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	165		5
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6
A-RS-FR4-ML-0.10mm-018+018-TG150-HF	50200646	18	L4	7
		100		
		18	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	120		8
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		9
A-RS-FR4-ML-0.10mm-018+018-TG150-HF	50200646	18	L6	10
		100		
		18	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	161		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
A-RS-FR4-ML-0.10mm-018+018-TG150-HF	50200646	18	L8	13
		100		
		18	L9	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	220		14
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		15
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	16

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1466 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik